

# 投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2026-004〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华西证券、天风证券、国泰基金、太平资产、东海证券、华福证券、溢锋私募、淳厚基金、鑫元基金、中金财富、彤源基金、新华基金、国联民生证券、华泰柏瑞基金、小红书、东方财富证券、交银施罗德、冠达泰泽基金
时间	2026-5-11及2026-5-13
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>Q:功率器件和散热对于碳化硅衬底的要求是否相同？</b></p> <p>A:这两种不同应用对于碳化硅衬底的要求存在一定差异。功率器件衬底对晶体缺陷控制要求极高，而散热在缺陷方面要求相对宽松，但对应力、翘曲度、TTV指标等要求更为严苛。由于两者关键指标要求不同，在相应的生产过程中成本控制方向也会不同。因此，作为晶体生长设备供应商，我们会通过与客户的紧密协作，把握下游应用领域的发展趋势，根据不同应用对于材料的特定要求，在晶体生长控制、功能配置等设备规格参数方面，进行与其相匹配的定制化设计与改进，实现品质性能与成本控制之间的平衡。</p> <p><b>Q:请问作为散热材料，碳化硅和金刚石哪一个发展速度会更快？</b></p> <p>A:碳化硅产业基础较为扎实，已形成从上游原材料到下游终端应用的完整产业链，并已具备大企业牵头产业化落地和规模化</p>

应用的优势。随着技术持续迭代升级，碳化硅的良率持续提升，应用场景也在不断拓展。而金刚石目前仍受大尺寸加工难度高、量产成本较高等因素制约。从现阶段来看，金刚石的产业化推进节奏滞后于碳化硅。

**Q: 请问公司边抛产品在半导体硅方面的市场竞争格局如何?**

A: 公司新并购的子公司的边抛设备在产品性能指标、稳定性等方面均可对标日系同类设备，现已成为其国内下游客户端的国产主力供应商，可对进口边抛设备实现较高程度的国产替代。

**Q: 公司目前产能情况如何?**

A: 公司不同品类产品对于产能的耗用情况不同。若将产能全部投放于碳化硅业务，则现阶段可满足每月约100台碳化硅单晶炉的配套生产需求。由于公司不涉及零部件的生产加工，整体产能配置可灵活调整，具备较大的产能弹性空间。